

行业月度点评

电子

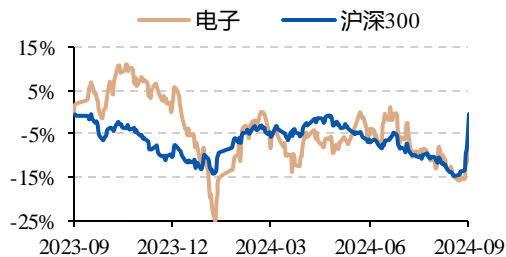
半导体设备销售额维持高位，国产替代前景可期

2024年09月27日

评级 **领先大市**

评级变动: 维持

行业涨跌幅比较



%	1M	3M	12M
电子	8.99	1.11	-2.84
沪深300	11.42	6.42	0.29

何晨 分析师

执业证书编号:S0530513080001
hechen@hncasing.com

袁鑫 研究助理

yuanxin@hncasing.com

相关报告

- 1 电子行业 2024 年 8 月报: 覆铜板进口均价同比上涨 33%，高端 PCB 保持景气 2024-08-28
- 2 PCB 行业深度: 科技进步与周期回暖交汇, PCB 迎发展机遇 2024-07-29
- 3 电子行业 2024 年 7 月报: 结构性需求支撑 PCB 龙头业绩向好 2024-07-29

重点股票	2023A		2024E		2025E		评级
	EPS (元)	PE (倍)	EPS (元)	PE (倍)	EPS (元)	PE (倍)	
沪电股份	0.79	50.84	1.34	29.97	1.70	23.62	买入
鹏鼎控股	1.42	25.19	1.55	23.08	1.87	19.13	买入
胜宏科技	0.78	50.90	1.32	30.08	1.84	21.58	买入

资料来源: iFinD, 财信证券

投资要点:

- **市场行情回顾:**报告期内,申万电子指数+9.1%,在申万一级行业中排名第24。申万电子三级行业全部上涨,涨幅中位数为+10.3%。涨跌幅前三分别为品牌消费电子(+15.1%)、电子化学品(+13.8%)、分立器件(+13.1%),涨跌幅后三分别为数字芯片设计(+8.2%)、半导体设备(+5.6%)、印制电路板(+3.9%)。
- **半导体销售额保持增长,中国7月销售额同比+19.5%。**全球半导体销售额7月实现513亿美元,同比+18.7%;1-7月累计实现3374亿美元,同比+17.8%。中国半导体销售额7月实现152亿美元,同比+19.5%;1-7月累计实现1024亿美元,同比+24.8%。低基数下的温和复苏,叠加AI、自动驾驶等结构性需求拉动,2024年以来的半导体月度销售额同比持续,中国半导体销售额增速高于全球水平,低谷后迎来反弹。
- **存储芯片价格底部反弹后趋于平稳,报告期内出现一定回调。**DDR3、4、5现货均价与8月23日相比,分别-3.3%、-1.0%、-3.3%。256、512GB SSD行业市场价与8月20日相比,分别-5.9%、-5.2%,现货价格随行就市,在一定程度上反映当前供需关系。
- **中国半导体设备销售额仍表现亮眼,2024Q2同比+61.7%。**2023年,在全球半导体设备市场规模缩水的背景下,中国大陆市场在二季度开始逆势增长。2024年二季度,中国大陆半导体设备销售额实现122.1亿美元,同比+61.7%;2024年累计实现247.3亿美元,同比+84.4%。我们推测主要原因是:进口限制的背景下,半导体产业关键设备的进口需求得到提前释放,产能逐步建设增加产业设备需求。
- **终端需求温和复苏。**二季度,全球智能手机出货2.85亿台,同比+7.6%,环比-1.4%;中国智能手机出货0.72亿台,同比+9.0%,环比+3.3%。8月,中国手机出货量为2404万台,同比+26.7%。二季度,全球PC出货量为6490万台,同比+5.4%,环比+8.5%,出货量与疫情前季度出货量水平相近。8月,新能源汽车销量实现110万辆,同比+30.0%
- **印制电路用覆铜板进出口保持景气。**8月印制电路板用覆铜板主要为量增价跌,进出口金额整体持续上行。金额上,8月进口金额实现1.08亿美元,同比+15%,环比+5%;出口金额实现0.54亿美元,同比+34%,环比+4%。1-8月累计进口7.38亿美元,同比+24%;累计出口4.24亿

美元,同比+18%。8月整体量增价跌,进出口金额较去年同期仍有较大涨幅。

- **台湾PCB行业营收同比持续增长,AI服务器及FPC相关企业营收亮眼。**台湾PCB厂商8月实现营收720亿新台币,同比增长15%,环比增长7%;年初至8月累计营收4847亿新台币,同比增长10%。公司层面,AI服务器及FPC相关企业业绩更佳,金像电8月实现营收36亿新台币,同比增长30%,环比增长1%;年初至8月累计营收256亿新台币,同比增长37%。
- **投资建议:**2024年全球PCB市场有望迎来复苏,高多层板、HDI板、封装基板有望在中长期保持较高增速。根据月度数据判断,预计行业正温和复苏,建议关注PCB中具有更高增速及壁垒的细分领域。1)数通板:全球通用人工智能技术加速演进,AI服务器及高速网络系统的旺盛需求对大尺寸、高速高多层板的需求推动有望持续,建议关注:沪电股份、胜宏科技、深南电路、奥士康、生益电子等。2)汽车板:汽车行业电气化、智能化和网联化等技术升级迭代和渗透率提升将为多层、高阶HDI、高频高速等方向的汽车板细分市场提供强劲的长期增长机会。建议关注:世运电路、沪电股份、景旺电子、胜宏科技等。3)消费电子领域:下半年通常为消费电子旺季,叠加苹果发力端侧AI,消费电子领域PCB有望迎来增长,建议关注:鹏鼎控股、东山精密。4)封装基板:半导体国产化大势所趋,建议关注:积极布局封装基板的深南电路、兴森科技。5)覆铜板:重点关注在高端产品不断取得突破的生益科技、华正新材、南亚新材。
- **风险提示:**市场需求复苏不及预期;产品技术发展不及预期;原材料供应及价格波动风险;经贸摩擦等外部环境风险

内容目录

1 行情回顾	5
2 半导体景气度跟踪	6
2.1 半导体销售额	6
2.2 存储芯片价格	7
2.3 半导体设备销售额	8
2.4 台湾晶圆代工企业营收	9
3 终端需求景气度跟踪	10
4 PCB 行业跟踪	12
4.1 印制电路用覆铜板进出口情况	12
4.2 台湾 PCB 行业营收情况	13
4.3 台湾 PCB 公司营收情况	14
5 行业及公司动态	14
5.1 行业新闻	14
5.1.1 工信部公布国产光刻机相关信息	14
5.1.2 苹果发布 iPhone 16 等新产品	15
5.1.3 华为发布首款三折叠屏手机	15
5.2 公司动态	15
5.2.1 鹏鼎控股发布 8 月营收简报：8 月营收同比增长 25.56%	15
5.2.2 胜宏科技发布回购报告书：回购资金总额不低于 0.7 亿元且不超过 1.4 亿元	16
5.2.3 鹏鼎控股发布关于向激励对象授予限制性股票的公告	16
6 投资建议	16
7 风险提示	17

图表目录

图 1：申万一级行业 8 月 23 日至 9 月 27 日区间涨跌幅（%）	5
图 2：申万电子三级行业 8 月 23 日至 9 月 27 日区间涨跌幅（%）	5
图 3：申万电子 PE-TTM（整体法）	6
图 4：申万电子 PE-TTM（中位数法）	6
图 5：全球半导体月销售额（亿美元）	7
图 6：全球半导体年累计销售额（亿美元）	7
图 7：中国半导体月销售额（亿美元）	7
图 8：中国半导体年累计销售额（亿美元）	7
图 9：DRAM 现货平均价（美元）	8
图 10：SSD 市场平均价（美元）	8
图 11：全球半导体设备季度销售额（亿美元）	8
图 12：全球半导体设备累计销售额（亿美元）	8
图 13：中国大陆半导体设备季度销售额（亿美元）	9
图 14：中国大陆半导体设备累计销售额（亿美元）	9
图 15：日本半导体设备出货额	9
图 16：台积电月度营收（亿新台币）	10
图 17：联电月度营收（亿新台币）	10
图 18：全球智能手机季度出货量（亿台）	10
图 19：中国智能手机季度出货量（亿台）	10

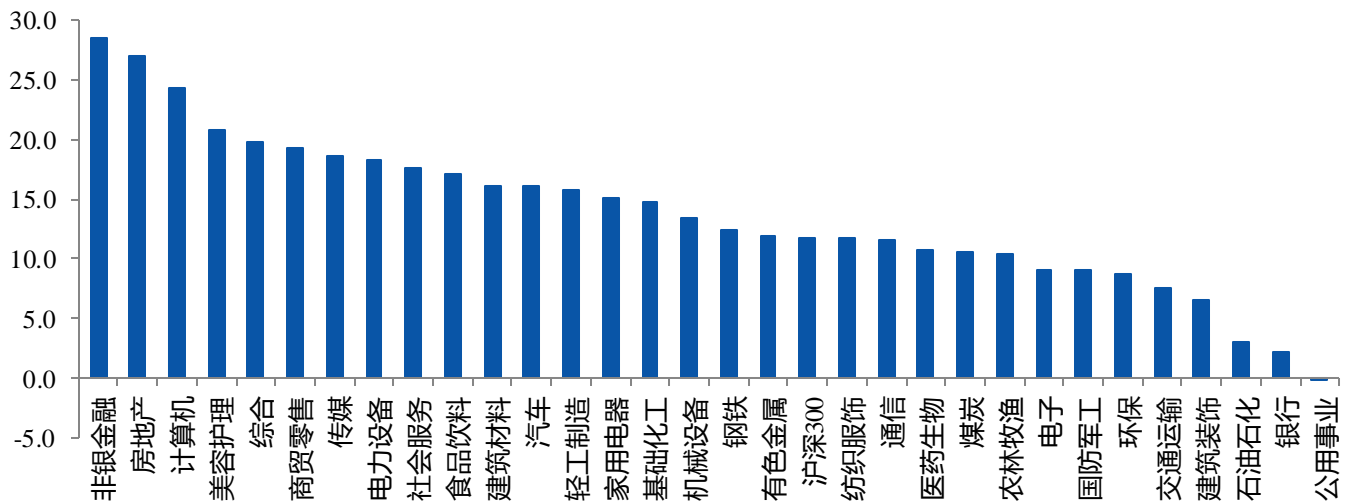
图 20: 中国手机月度出货量 (万部)	11
图 21: 上市新机型数量 (款)	11
图 22: 全球 PC 季度出货量 (万台)	11
图 23: 华硕&宏碁合计月度营收情况 (亿新台币)	11
图 24: 汽车当月销量 (万辆)	12
图 25: 新能源汽车当月销量 (万辆)	12
图 26: 汽车全年累计销量 (万辆)	12
图 27: 新能源汽车全年累计销量 (万辆)	12
图 28: 印制电路用覆铜板月进出口数量 (吨)	13
图 29: 印制电路用覆铜板月进出口均价 (美元/吨)	13
图 30: 印制电路用覆铜板月进出口金额 (万美元)	13
图 31: 印制电路用覆铜板年进出口金额 (亿美元)	13
表 1: 申万电子个股涨跌幅 (%)	6
表 2: 台湾 PCB 行业营收 (亿新台币)	13
表 3: 台股 PCB 公司 8 月营收情况 (亿新台币)	14

1 行情回顾

报告期内,申万电子指数+9.1%,在申万一级行业中排名第 24。2024 年 8 月 23 日至 9 月 27 日,沪深 300 指数+11.8%,非银金融涨幅最大(+28.4%),公用事业跌幅最大(-0.2%),申万一级行业指数涨跌中位数为+12.9%。电子上涨 9.1%,排名第 24,涨幅中等偏低。

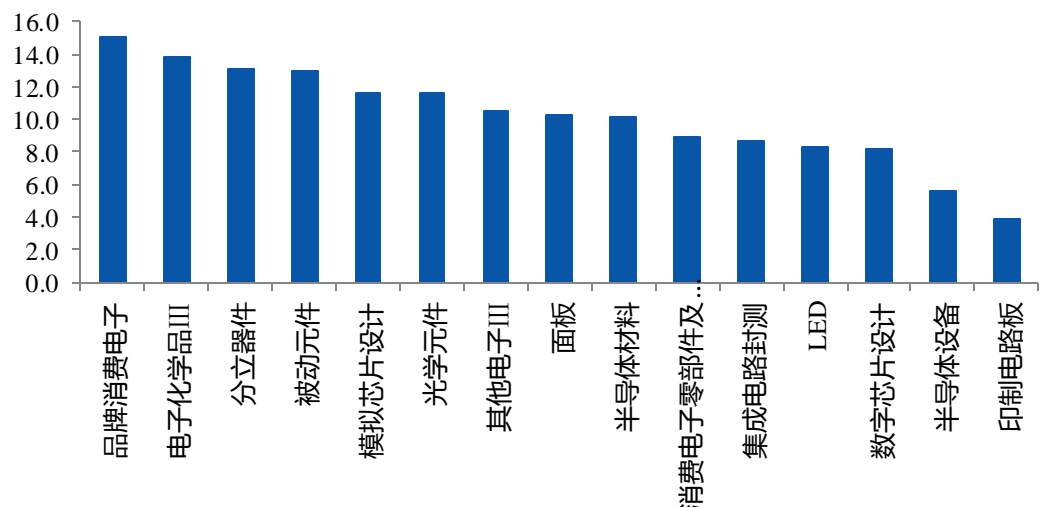
报告期内,PCB 指数+3.9%,在申万电子三级行业中排名第 15。2024 年 8 月 23 日至 9 月 27 日,申万电子三级行业全部上涨,涨幅中位数为+10.3%。涨跌幅前三分别为品牌消费电子(+15.1%)、电子化学品(+13.8%)、分立器件(+13.1%),涨跌幅后三分别为数字芯片设计(+8.2%)、半导体设备(+5.6%)、印制电路板(+3.9%)。

图 1: 申万一级行业 8 月 23 日至 9 月 27 日区间涨跌幅 (%)



资料来源: 同花顺, 财信证券

图 2: 申万电子三级行业 8 月 23 日至 9 月 27 日区间涨跌幅 (%)



资料来源: 同花顺, 财信证券

个股方面,8月23日至9月27日,申万电子个股涨跌中位数为9.9%。剔除上市天数不足200天个股及ST股,涨幅前五分别为深圳华强(73.2%)、科森科技(66.7%)、华映科技(48.0%)、传艺科技(43.0%)、安克创新(34.3%),涨幅后五分别为则成电子(-16.9%)、力源信息(-12.1%)、沃尔核材(-11.8%)、方邦股份(-8.1%)、寒武纪(-7.6%)。

表 1: 申万电子个股涨跌幅 (%)

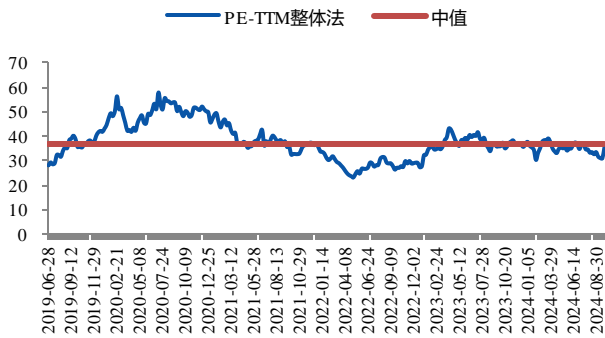
涨幅前五名				涨幅后五名			
股票代码	公司简称	主营业务	涨跌幅	股票代码	公司简称	主营业务	涨跌幅
000062.SZ	深圳华强	电子交易服务	+73.2	837821.BJ	则成电子	印制电路板	-16.9
603626.S							
H	科森科技	消费电子零部件	+66.7	300184.SZ	力源信息	元器件分销	-12.1
000536.SZ	华映科技	显示面板	+48.0	002130.SZ	沃尔核材	电子、电线产品	-11.8
002866.SZ	传艺科技	消费电子零部件	+43.0	688020.SH	方邦股份	PCB	-8.1
300866.SZ	安克创新	品牌消费电子	+34.3	688256.SH	寒武纪	数字芯片设计	-7.6

资料来源: 同花顺, 财信证券

备注: 时间区间为2024年8月23日-9月27日

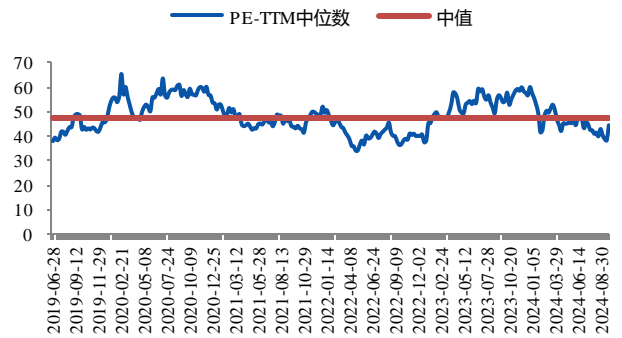
PE估值水平来到历史中低水平。近5年,申万电子板块整体法估值PE-TTM中值为37倍,中位数法估值PE-TTM中值为48倍。2024年9月27日,申万电子整体法PE-TTM为35倍,估值水平处于历史后38%分位;中位数法PE-TTM为45倍,估值水平处于历史后32%分位,申万电子行业PE估值来到历史中低水平。

图 3: 申万电子 PE-TTM (整体法)



资料来源: 同花顺, 财信证券

图 4: 申万电子 PE-TTM (中位数法)



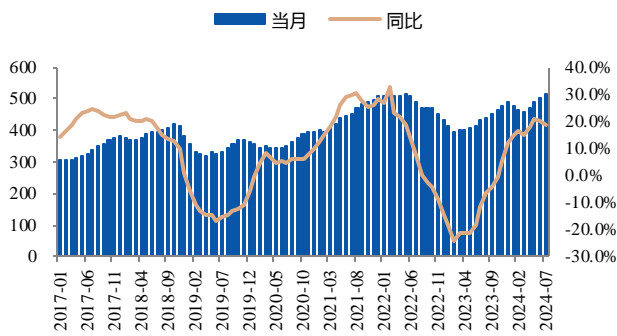
资料来源: 同花顺, 财信证券

2 半导体景气度跟踪

2.1 半导体销售额

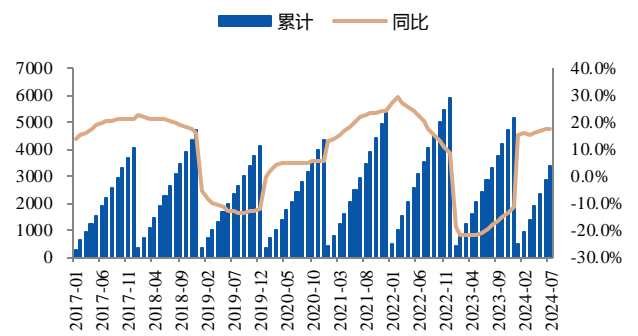
半导体销售额保持增长,中国7月销售额同比+19.5%。全球半导体销售额7月实现513亿美元,同比+18.7%;1-7月累计实现3374亿美元,同比+17.8%。中国半导体销售额7月实现152亿美元,同比+19.5%;1-7月累计实现1024亿美元,同比+24.8%。低基数下的温和复苏,叠加AI、自动驾驶等结构性需求拉动,2024年以来的半导体月度销售额同比持续,中国半导体销售额增速高于全球水平,低谷后迎来反弹。

图 5：全球半导体月销售额（亿美元）



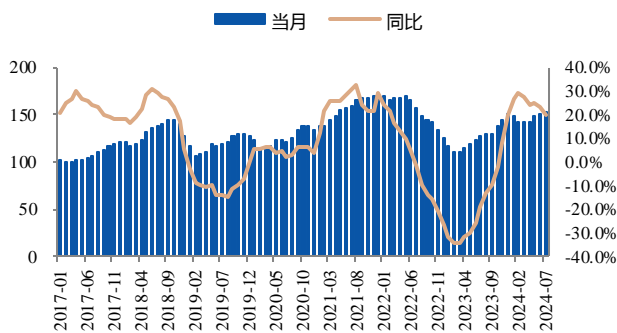
资料来源：SIA，财信证券

图 6：全球半导体年累计销售额（亿美元）



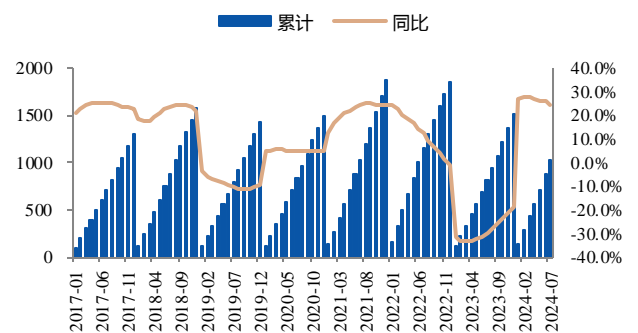
资料来源：SIA，财信证券

图 7：中国半导体月销售额（亿美元）



资料来源：SIA，财信证券

图 8：中国半导体年累计销售额（亿美元）



资料来源：SIA，财信证券

2.2 存储芯片价格

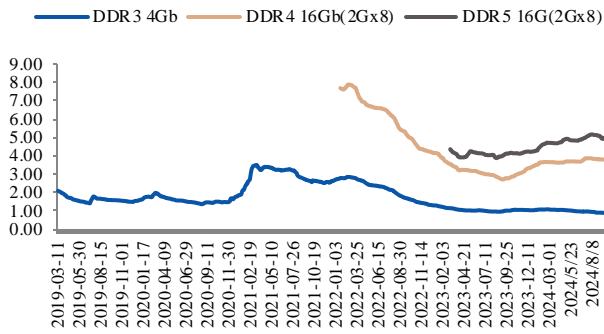
存储芯片价格底部反弹后趋于平稳。存储芯片市场规模占集成电路的 30% 左右，且价格存在明显的周期波动，对半导体产业趋势具有指示作用。

DRAM 产品，反弹趋于平稳，不同世代产品价格走势分化。9 月 27 日，DDR3、4、5 现货均价分别为 0.89、3.79、4.97 美元，与 8 月 23 日相比，分别-3.3%、-1.0%、-3.3%；与此前最低点价格相比，分别-7.3%、+39.3%、+28.1%。

NAND 产品，反弹趋于平稳，近期出现回调。9 月 24 日，256、512GBSSD 行业市场价分别为 16.0、27.5 美元，与 8 月 20 日相比，分别-5.9%、-5.2%，与此前最低点价格相比，分别+57%、+45%。触底反弹之后，SSD 价格增速放缓，并出现回调。

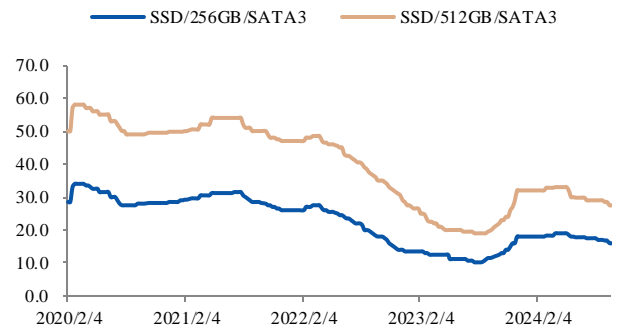
近期 DRAM 和 NAND 产品价格走势出现分化，DRAM 价格走势强于 NAND。我们推测可能的原因包含：1) 传统服务器及 AI 服务器等产品升级，拉动 DDR4、5 需求结构性回暖，而 NAND 的需求主要体现在容量的增大。2) 海外大厂加大 HBM 投资力度，挤压部分 DDR 产能，使得供给端减少。

图 9：DRAM 现货平均价（美元）



资料来源：DRAMexchange，财信证券

图 10：SSD 市场平均价（美元）



资料来源：CFM，财信证券

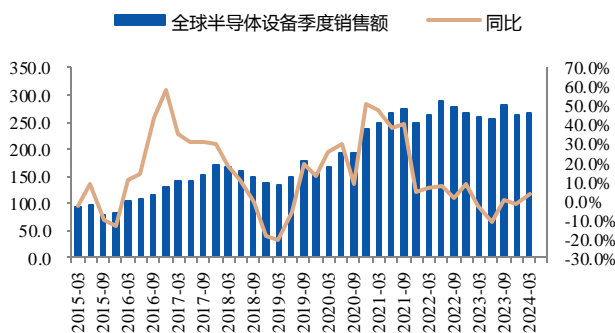
2.3 半导体设备销售额

2020—2022 年大扩产后，全球半导体设备销售额增速短期放缓，中国大陆受自主可控等多重因素影响，半导体设备销售额仍表现亮眼。1) 全球半导体设备销售额 2024Q2 实现 267.8 亿美元，同比+3.8%；2024 年累计实现 532.0 亿美元，同比+1.1%。2) 中国大陆半导体设备销售额 2024Q2 实现 122.1 亿美元，同比+61.7%；2024 年累计实现 247.3 亿美元，同比+84.4%。

2023 年，在全球半导体设备市场规模缩水的背景下，中国大陆市场在二季度开始逆势增长。2024 年二季度，中国大陆半导体设备销售额仍然维持高位，同比保持高增长。我们推测主要原因是：制裁加剧背景下，半导体产业关键设备的进口需求得到提前释放，产能逐步建设增加产业设备需求。

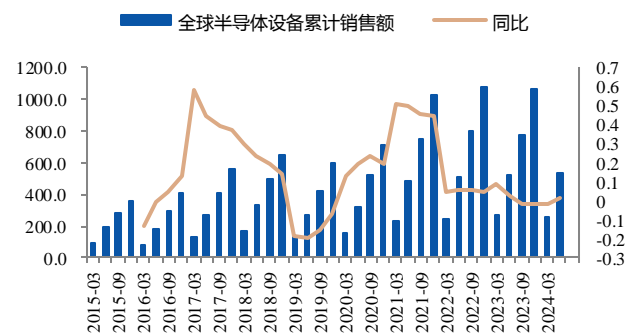
设备销售额大增，有望为国产科技提供有力支持。中长期看，2023 年中旬开始大幅增长的设备进口额，将逐步转换为芯片制造能力，国产芯片产能有望大幅增长。一般情况下，新增产线建设需要约两年时间，考虑选址、建厂等时间缩短等因素，设备投产时间有望进一步缩短。

图 11：全球半导体设备季度销售额（亿美元）



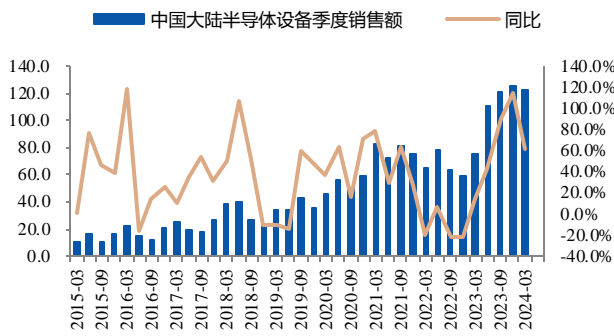
资料来源：SEAJ，财信证券

图 12：全球半导体设备累计销售额（亿美元）



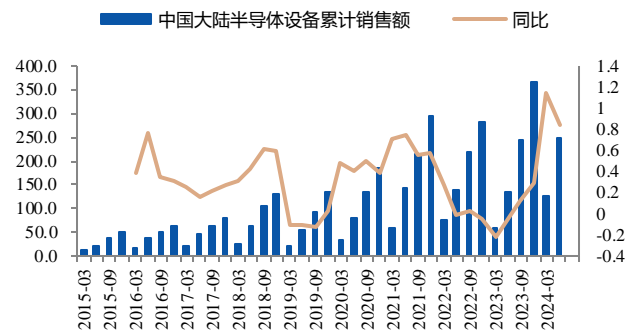
资料来源：SEAJ，财信证券

图 13：中国大陆半导体设备季度销售额（亿美元）



资料来源：SEAJ，财信证券

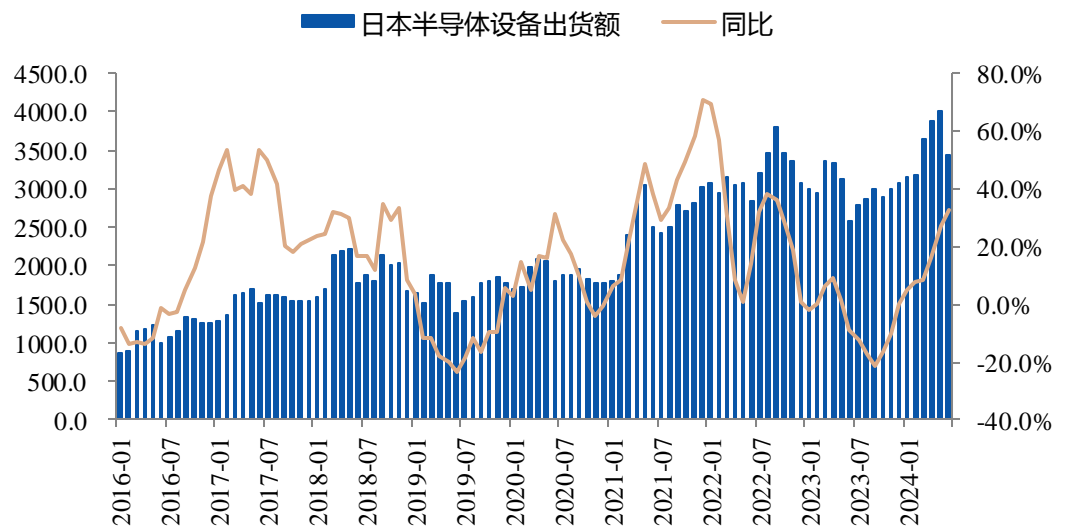
图 14：中国大陆半导体设备累计销售额（亿美元）



资料来源：SEAJ，财信证券

日本半导体设备出货额同比持续增长。2024 年 8 月，日本半导体设备出货额达到 3510 亿元，同比+22.5%，环比+0.9%。今年 1 月以来，日本半导体设备出货额同比增长。

图 15：日本半导体设备出货额

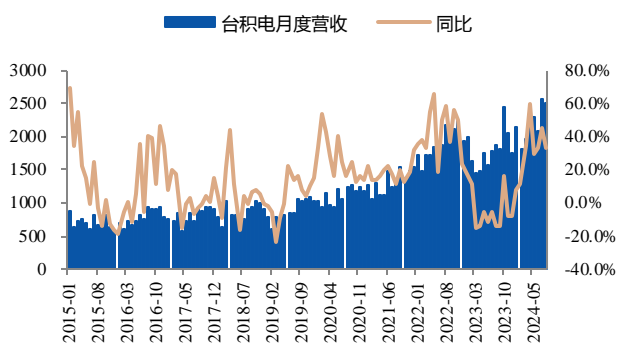


资料来源：SEAJ，财信证券

2.4 台湾晶圆代工企业营收

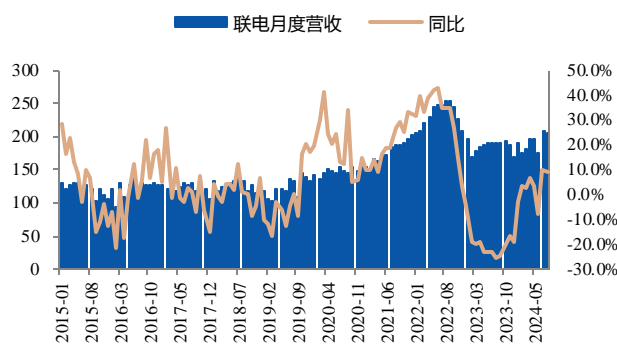
台积电 8 月营收同比+33.0%，先进制程需求旺盛。台积电是全球晶圆代工龙头，充分受益于 AI 及高性能运算等前沿技术发展。台积电 8 月实现营收 2509 亿新台币，同比+33.0%；1-8 月累计营收 17738 亿新台币，同比+30.8%，先进制程需求持续旺盛。联电 8 月营收同比+8.9%，成熟制程需求有望回暖。联电是全球第三大晶圆代工厂，制程技术以成熟节点为主。联电 8 月实现营收 207 亿新台币，同比+8.9%；1-8 月累计营收 1530 亿新台币，同比+3.0%，成熟制程需求有望逐步企稳回暖。

图 16: 台积电月度营收 (亿新台币)



资料来源: 台湾证券交易所, 财信证券

图 17: 联电月度营收 (亿新台币)



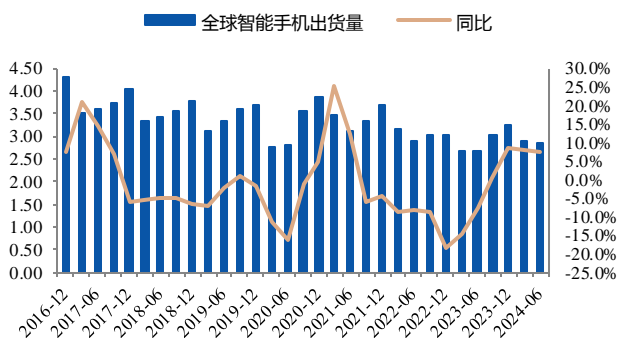
资料来源: 台湾证券交易所, 财信证券

3 终端需求景气度跟踪

PCB 行业下游应用领域基本涉及所有的电子产品, 主要应用领域包括通信、3C 类消费电子、计算机及服务器、汽车电子、工控医疗以及航空航天等行业。根据 Prismark 数据, 2023 年全球 PCB 下游中, 占比靠前的应用主要有手机 18.7%, PC 13.6%, 其他消费电子 12.9%, 服务器/数据存储 11.8%, 有线基础设施 8.6%, 无线基础设施 4.6%。

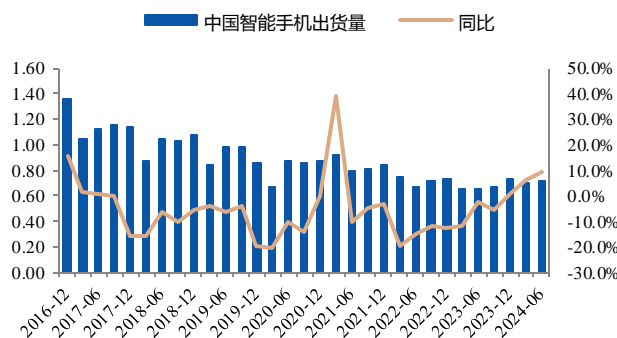
智能手机二季度出货量回暖, 同比+7.6%。2024 年二季度, 全球智能手机出货 2.85 亿台, 同比+7.6%, 环比-1.4%; 中国智能手机出货 0.72 亿台, 同比+9.0%, 环比+3.3%。低基数叠加温和复苏, 今年上半年智能手机出货量实现回暖。

图 18: 全球智能手机季度出货量 (亿台)



资料来源: IDC, 财信证券

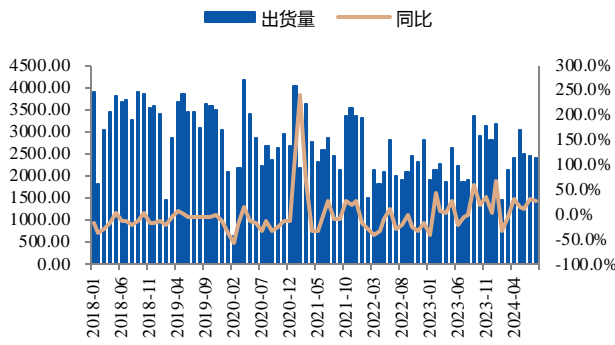
图 19: 中国智能手机季度出货量 (亿台)



资料来源: IDC, 财信证券

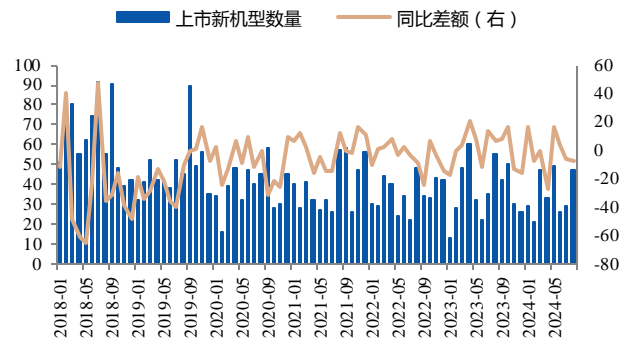
中国 8 月手机出货量回暖, 同比+26.7%。2024 年 8 月, 中国手机出货量为 2404 万台, 同比+26.7%。二季度以来, 手机月出货量均实现同比高增长。从上市新机型数量看, 8 月上市新机型 47 款, 进入消费旺季, 新机型数量环比增加 18 款, 但比去年同期减少 8 款。

图 20：中国手机月度出货量（万部）



资料来源：工信部，财信证券

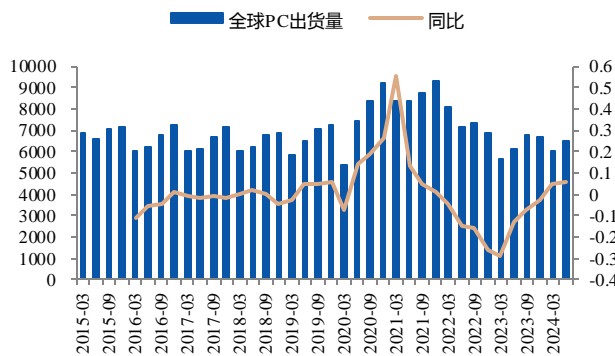
图 21：上市新机型数量（款）



资料来源：工信部，财信证券

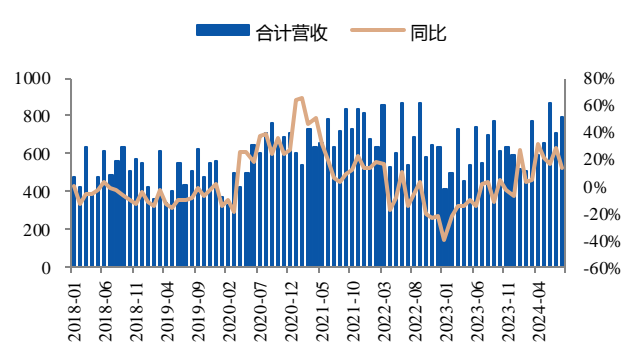
二季度 PC 出货量同比+5.4%，华硕&宏碁月度营收持续增长。2024 年二季度，全球 PC 出货量为 6490 万台，同比+5.4%，环比+8.5%，出货量与疫情前季度出货量水平相近。华硕&宏碁月度营收持续增长，8 月合计实现营收 800 亿新台币，同比增长 14%。疫情期间 PC 及平板需求得到集中释放，随后需求承压，预计在换机周期及产品创新等因素的影响下，PC 市场有望迎来复苏。

图 22：全球 PC 季度出货量（万台）



资料来源：同花顺，财信证券

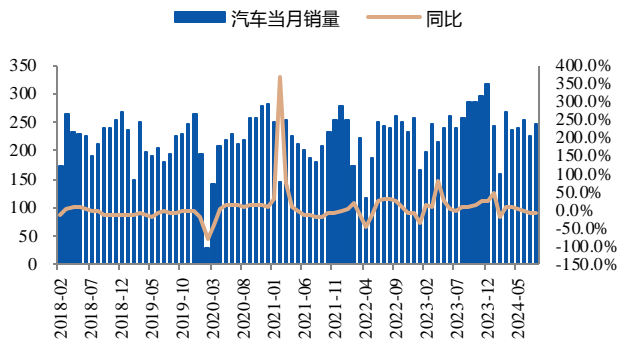
图 23：华硕&宏碁合计月度营收情况（亿新台币）



资料来源：同花顺，财信证券

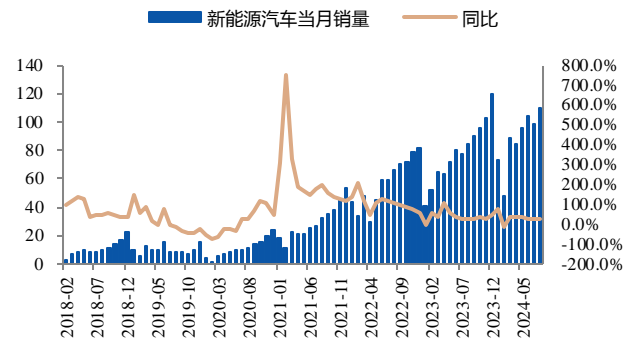
新能源汽车销量维持高增长。2024 年 8 月，全国汽车销量实现 245 万辆，同比-5.0%；新能源汽车销量实现 110 万辆，同比+30.0%；1-8 月，汽车销量累计 1875 万辆，同比+3.0%；新能源汽车销量累计 704 万辆，同比+30.9%。2024 年 1-8 月，新能源汽车渗透率为 37.5%，去年全年为 31.6%。汽车行业电气化、智能化和网联化等变化不断推进，单车 PCB 等电子器件价值量得到显著提升，新能源汽车成为 PCB 等电子器件的主要需求之一。

图 24：汽车当月销量（万辆）



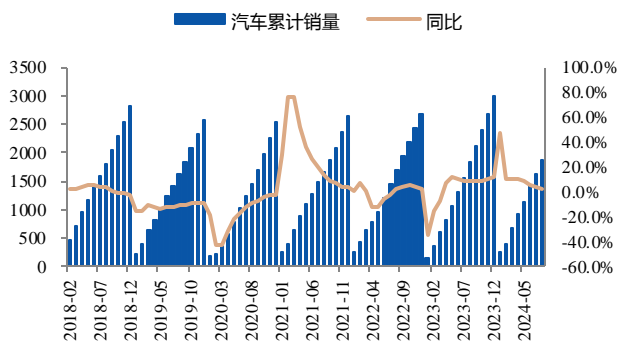
资料来源：中汽协，财信证券

图 25：新能源汽车当月销量（万辆）



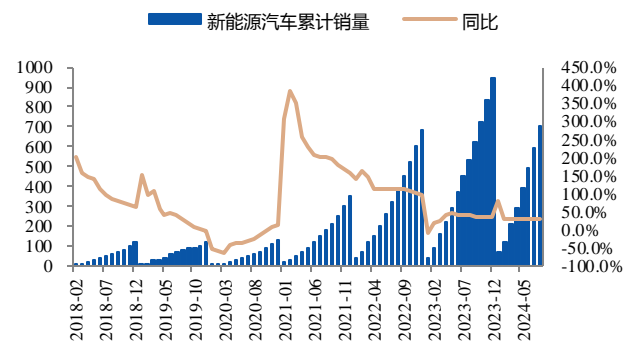
资料来源：中汽协，财信证券

图 26：汽车全年累计销量（万辆）



资料来源：中汽协，财信证券

图 27：新能源汽车全年累计销量（万辆）



资料来源：中汽协，财信证券

4 PCB 行业跟踪

4.1 印制电路用覆铜板进出口情况

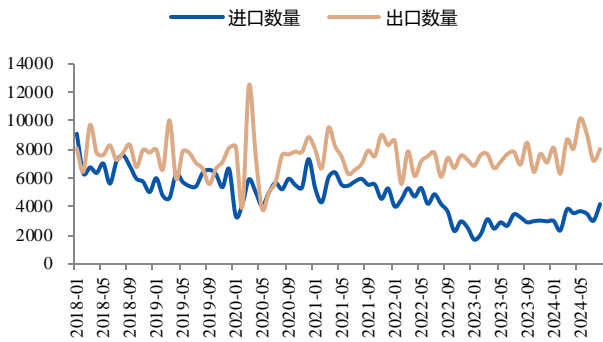
印制电路用覆铜板 8 月进出口情况持续乐观，金额同比仍有增长，具体如下：

数量上，8 月进口 4173 吨，同比+29%，环比+39%；出口 8037 吨，同比+16%，环比+11%。8 月进出口数量同环比均出现一定涨幅。

均价上，8 月进口均价 2.61 万美元/吨，同比-10%，环比-24%；出口均价 0.67 万美元/吨，同比+16%，环比-7%。进口价格波动较大，长期震荡上行；出口价格相对稳定。7 月价格均出现一定涨幅，预计一方面受原材料价格波动影响，另一方面 AI 等技术发展对产品提出更高要求，拉动价格上涨。

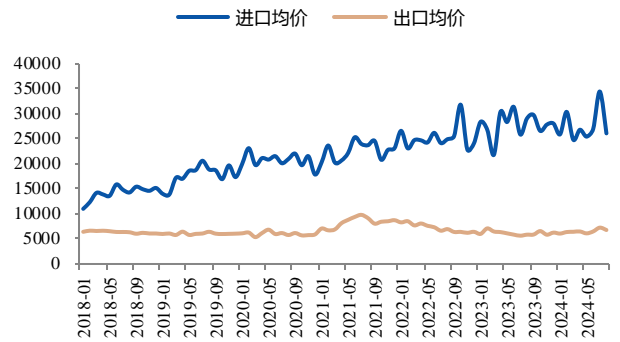
金额上，8 月进口金额实现 1.08 亿美元，同比+15%，环比+5%；出口金额实现 0.54 亿美元，同比+34%，环比+4%。1-8 月累计进口 7.38 亿美元，同比+24%；累计出口 4.24 亿美元，同比+18%。8 月整体量增价跌，进出口金额较去年同期仍有较大涨幅。

图 28：印制电路用覆铜板月进出口数量（吨）



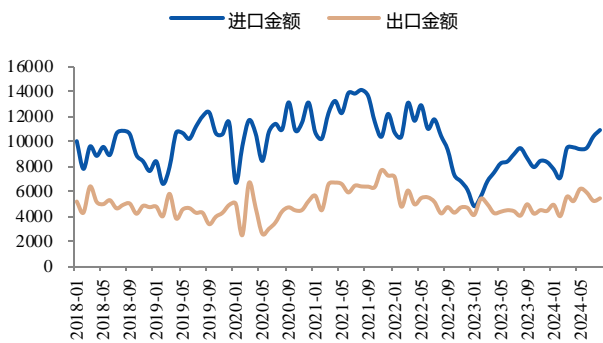
资料来源：海关总署，财信证券

图 29：印制电路用覆铜板月进出口均价（美元/吨）



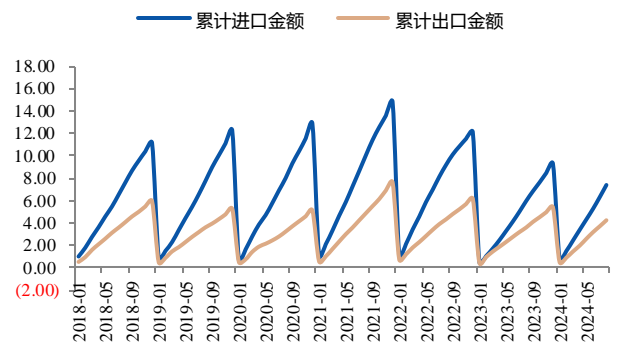
资料来源：海关总署，财信证券

图 30：印制电路用覆铜板月进出口金额（万美元）



资料来源：海关总署，财信证券

图 31：印制电路用覆铜板年进出口金额（亿美元）



资料来源：海关总署，财信证券

4.2 台湾 PCB 行业营收情况

台湾 PCB 厂商营收同比持续增长,8 月营收同比+15%。台湾 PCB 厂商 8 月实现营业收入 720 亿新台币,同比增长 15%,环比增长 7%;年初至 8 月累计营收 4847 亿新台币,同比增长 10%。其中,硬板厂 8 月实现营业收入 500 亿新台币,同比增长 14%,环比增长 2%;年初至 8 月累计营收 3541 亿新台币,同比增长 10%。软板厂 8 月实现营业收入 220 亿新台币,同比增长 17%,环比增长 22%;年初至 8 月累计营收 1306 亿新台币,同比增长 12%。原材料端,原材料厂 8 月实现营业收入 541 亿新台币,同比增长 3%,环比增长 1%;年初至 8 月累计营收 4050 亿新台币,同比增长 6%。其中,CCL 厂 8 月实现营业收入 338 亿新台币,同比增长 5%,环比增长-1%;年初至 8 月累计营收 2508 亿新台币,同比增长 8%。FCCL 厂 8 月实现营业收入 11 亿新台币,同比增长 13%,环比增长-4%;年初至 8 月累计营收 80 亿新台币,同比增长 29%。台湾 PCB 行业保持景气,月度营收同比持续增长。

表 2：台湾 PCB 行业营收（亿新台币）

行业简称	8 月营收	同比 (%)	环比 (%)	全年累计营收	同比 (%)
PCB 厂：合计	720	15%	7%	4847	10%

硬板	500	14%	2%	3541	10%
软板	220	17%	22%	1306	12%
原材料厂：合计	541	3%	1%	4050	6%
CCL	338	5%	-1%	2508	8%
FCCL	11	13%	-4%	80	29%
玻璃纱/布	41	-14%	3%	319	-3%
铜箔	100	6%	4%	777	3%
其他	51	6%	5%	367	9%

资料来源：台湾电路板协会，财信证券

4.3 台湾 PCB 公司营收情况

AI 服务器及 FPC 相关企业业绩更佳。1) 服务器相关多层板、HDI 板企业业绩维持增长，金像电 8 月实现营收 36 亿新台币，同比增长 30%，环比增长 1%；年初至 8 月累计营收 256 亿新台币，同比增长 37%。景硕科技 8 月实现营收 29 亿新台币，同比增长 34%，环比增长 6%；年初至 8 月累计营收 198 亿新台币，同比增长 14%。2) FPC 板营收同比表现亮眼。臻鼎 8 月实现营收 178 亿新台币，同比增长 29%，环比增长 32%；年初至 8 月累计营收 962 亿新台币，同比增长 21%。

表 3：台股 PCB 公司 8 月营收情况（亿新台币）

股票代码	公司简称	业务类型	8 月营收	同比 (%)	环比 (%)	累计营收	同比 (%)
3037.TW	欣兴	载板、HDI	108	17%	8%	752	8%
8046.TW	南电	载板	31	-8%	-1%	214	-27%
3189.TW	景硕	载板	29	34%	6%	198	14%
4958.TW	臻鼎	FPC、HDI	178	29%	32%	962	21%
3044.TW	健鼎	多层板	59	8%	1%	429	12%
2313.TW	华通	HDI、软硬结合板	70	8%	4%	462	16%
5469.TW	瀚宇博	多层板（笔电）	40	1%	1%	276	-5%
2368.TW	金像电	多层板（通信）	36	30%	1%	256	37%
6269.TW	台郡	FPC	21	-20%	-10%	188	-11%
2355.TW	敬鹏	多层板（汽车）	14	-7%	6%	110	1%
8213.TW	志超	多层板（光电）	16	-13%	-8%	122	-7%
2367.TW	耀华	FPC、软硬结合板	16	21%	-1%	125	24%

资料来源：台湾证券交易所，财信证券

5 行业及公司动态

5.1 行业新闻

5.1.1 工信部公布国产光刻机相关信息

9月9日，工信部公布《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》。其中，在集成电路生产设备中包含氟化氪光刻机(简称“KrF”)、氟化氩光刻机(简称“ArF”)。根据工信部文件所示的核心技术指标，KrF光刻机分辨率 $\leq 110\text{nm}$ ，套刻 $\leq 25\text{nm}$ ；ArF光刻机分辨率 $\leq 65\text{nm}$ ，套刻精度 $\leq 8\text{nm}$ 。从披露信息判断，此次公布的两款光刻机均为干式光刻机，制程相对成熟。科技自主可控备受关注，官方披露光刻机设备进展有望提振市场信心。

资料来源：工信部，每日经济新闻

5.1.2 苹果发布 iPhone 16 等新产品

北京时间9月10日凌晨，苹果举行了新品发布会，先后发布 Apple Watch Series 10 智能手表、AirPods 4 耳机新品和 iPhone 16 系列手机。手机方面，iPhone 16 全系配备新的 A18 芯片，内存全系从 6G 升级到 8G，处理器及内存芯片升级，有望提升手机性能及 AI 处理能力。售价上，iPhone 16，5999 元起，iPhone 16 Plus，6999 元起；iPhone 16 Pro，7999 元起；iPhone 16 Pro Max，9999 元起。硬件有所升级的情况下，iPhone 16 定价与往年持平，有望增加市场竞争力。

资料来源：苹果

5.1.3 华为发布首款三折叠屏手机

2024年9月10日，华为公司举办华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，期间发布华为全球首款三折叠屏手机(Mate XT 非凡大师)。该手机展开最大 10.2 英寸，展开最薄 3.6mm；价格方面。256GB 版本售价 19999 元，512GB 版本 21999 元，1TB 版本售价 23999 元。Mate XT 非凡大师将于 9 月 20 日 10:08 正式开售。

援引 36kr 消息，中国折叠屏手机 2023 年出货量约 610 万台，同比增长 69.1%；预计 2024 年出货量约 1070 万台，同比增长 74.5%。折叠屏手机正在吸引越来越多消费者购买，在售价超过 600 美元的高端手机市场中的市占率逐步提升，2022、2023、2024 年(预测)分别为 6%、9%、14%。本次华为发布全球首款三折叠屏手机，有望使得更多用户关注到折叠屏手机。

资料来源：华为，36Kr

5.2 公司动态

5.2.1 鹏鼎控股发布 8 月营收简报：8 月营收同比增长 25.56%

公司发布 2024 年 8 月营业收入简报，8 月实现营收 36.74 亿元，较去年同期增长 25.56%。2024 年 1-8 月，公司营收累计 194.75 亿元，较去年同期增长 17.04%。

鹏鼎控股主营产品为 FPC，下游需求主要为消费电子类产品。上半年通常为消费电子需求淡季，下半年为旺季。公司产品定位中高端 PCB，有望充分受益于消费电子回暖及端侧 AI 发展，预计公司稼动率有望逐步提升，营收同比保持增长。

资料来源：公司公告

5.2.2 胜宏科技发布回购报告书：回购资金总额不低于 0.7 亿元且不超过 1.4 亿元

2024 年 9 月 14 日，胜宏科技发布回购报告书，称公司计划以自有资金回购部分公司已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励。

本次回购的资金总额不低于人民币 7,000 万元且不超过人民币 14,000 万元（均含本数）；回购价格不超过 47.59 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，回购股份数量约为 1,470,898 股至 2,941,794 股，占公司目前已发行总股本比例为 0.17% 至 0.34%。

本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

资料来源：公司公告

5.2.3 鹏鼎控股发布关于向激励对象授予限制性股票的公告

公司发布关于向激励对象授予限制性股票的公告，1) 本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。2) 本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 946.99 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 231,856.0816 万股的 0.41%。3) 本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为 17.70 元/股。4) 本激励计划授予的限制性股票在授予登记日起满 12 个月后，分 3 期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%。

业绩考核要求上，本次激励计划的限制性股票考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。加权平均净资产收益率目标值为高于当年行业平均的 50%，触发值为 10%；2024-2026 年目标营业收入分别为 403、428、438 亿元，触发值为 80%。公司 2023 年营收为 320.66 亿元，若 2024 年营收达到目标值，则营收同比增长 25.7%。

资料来源：公司公告

6 投资建议

2024 年全球 PCB 市场有望迎来复苏，高多层板、HDI 板、封装基板有望在中长期保持较高增速。根据月度数据判断，预计行业正温和复苏，**建议关注 PCB 中具有更高增速及壁垒的细分领域。**

1) 数通板：全球通用人工智能技术加速演进，AI 服务器及高速网络系统的旺盛需求对大尺寸、高速高多层板的需求推动有望持续，建议关注：沪电股份、胜宏科技、深南电路、奥士康、生益电子等。

2) 汽车板：汽车行业电气化、智能化和网联化等技术升级迭代和渗透率提升将为多层、高阶 HDI、高频高速等方向的汽车板细分市场提供强劲的长期增长机会。建议关注：世运电路、沪电股份、景旺电子等。

3) 消费电子领域：下半年通常为消费电子旺季，叠加苹果发力端侧 AI，消费电子领域 PCB 有望迎来增长，建议关注：鹏鼎控股、东山精密。

4) 封装基板：半导体国产化大势所趋，建议关注：积极布局封装基板的深南电路、兴森科技。

5) 覆铜板：重点关注在高端产品不断取得突破的生益科技、华正新材、南亚新材。

7 风险提示

市场需求复苏不及预期；产品技术发展不及预期；原材料供应及价格波动风险；经贸摩擦等外部环境风险。

评级系统说明

以报告发布日后的 6—12 个月内，所评股票/行业涨跌幅相对于同期市场指数的涨跌幅度为基准。

类别	投资评级	评级说明
股票投资评级	买入	投资收益率超越沪深 300 指数 15% 以上
	增持	投资收益率相对沪深 300 指数变动幅度为 5%—15%
	持有	投资收益率相对沪深 300 指数变动幅度为-10%—5%
	卖出	投资收益率落后沪深 300 指数 10% 以上
行业投资评级	领先大市	行业指数涨跌幅超越沪深 300 指数 5% 以上
	同步大市	行业指数涨跌幅相对沪深 300 指数变动幅度为-5%—5%
	落后大市	行业指数涨跌幅落后沪深 300 指数 5% 以上

免责声明

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，作者具有中国证券业协会注册分析师执业资格或相当的专业胜任能力。

本报告仅供财信证券股份有限公司客户及员工使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发送，概不构成任何广告。

本报告信息来源于公开资料，本公司对该信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本公司对已发报告无更新义务，若报告中所含信息发生变化，本公司可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司及本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此作出的任何投资决策与本公司及本公司员工或者关联机构无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人（包括本公司客户及员工）不得以任何形式复制、发表、引用或传播。

本报告由财信证券研究发展中心对许可范围内人员统一发送，任何人不得在公众媒体或其它渠道对外公开发布。任何机构和个人（包括本公司内部客户及员工）对外散发本报告的，则该机构和个人独自为此发送行为负责，本公司保留对该机构和个人追究相应法律责任的权利。

财信证券研究发展中心

网址：stock.hnchasing.com

地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 层

邮编：410005

电话：0731-84403360

传真：0731-84403438